

Dünndraht Wedge-Wedge Bonder 5630

Bond System

Drahttypen	Alu- und Golddrähte 17,5-75µm auf 2"-Spule
Bondkopf	Wedge-Wedge für Alu- und Golddrähte Standardkapillare 16mm Länge (optional 19mm) Motorisierte Drahtabspulung (optional)
Ultraschall System	F&S Generator 100kHz (optional 65, 140kHz)

Maschinen Basis

Achsen

- Arbeitsbereich X/Y-Achse 100x100mm
Z-Achse 60mm
- Schrittauflösung 0,25µm
- Wiederholgenauigkeit <2µm

Hardware

- Dual Core PC, 1,6 GHz Prozessor,
- 4 GB RAM, Ethernet, 4x USB-Hub Front
- Firewire CCD Farbkamera 1,4 MPixel
- Netzwerkfähig mit TCP/IP Server zur

Software

- Einzelbonds bis komplexe Programme,
- Loopformen in Bibliotheken speicherbar
- Optionale Bilderkennung

Geschwindigkeit 20 Drähte ≤ Minute

Abmessung B x T x H – 70 x 65 x 70 cm, Gewicht ca. 80kg

Anschlüsse 100–240 VAC, 1 Phase, 50/60 Hz, max 500 VA
Ø 6mm Standard-Vakuumschlauch

Heizung Steuerung in der Maschine integriert 0–250 °C

Die 56xx Serie:

Der semiautomatische Gold-Ball-Bonder 5630 ist auf Basis der 56xx-Serie voll PC-gesteuert und es sind beliebig viele Bonds oder Bumps programmierbar.

Die programmierten Zielpunkte werden über das Kamerazielfadenkreuz angefahren und die programmierten Bonds oder Bumps werden automatisch gebondet.

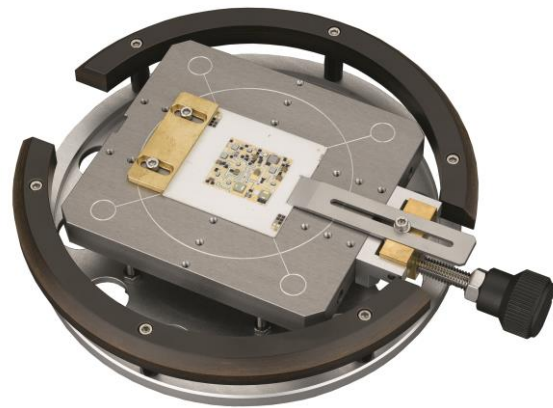
F&S Bondtec bietet bei dieser Maschine zwei Modis an: Singlebond zum Reparieren von div. Bondsamples und zum Setzen von Einzelbonds (manuell -automatisch) und Multiwire zum Teachen und Bonden von Chips oder div. Bondsamples (semi- u. vollautomatisch).

Durch einfachen Wechsel der Bondköpfe und der Software kann diese Maschine auch auf Ball-Wedge, Dickdraht Wedge Wedge oder Heavy Ribbon Bonder umgerüstet werden. Ebenso ist die Maschine als Pull-/Sheartester einsetzbar.

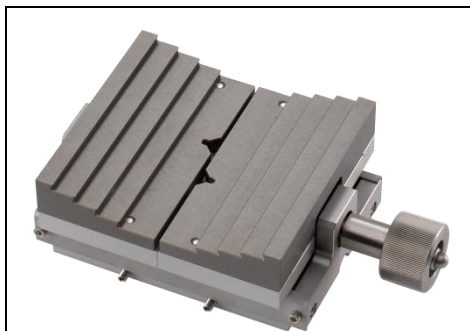
Werkzeugloses Umrüsten ist in ca. 3 Minuten möglich.

Substrathalter

Standard-Substrataufnahme
für Bauteile bis 4x4" mit
Vakuum und mechanischer Klemmung



Optional:



Substrathalter 4x4"
mit Stufenbacken



TO Aufnahme mit
mechanischer Klemmung



4x4" Substrataufnahme m.
gummierter Oberfläche, mit
mechanische Klemmung

F&S Bondtec Semiconductor GmbH

Industriezeile 49a

A-5280 Braunau am Inn

Tel.: +43-7722-67052-8270

Fax: +43-7722-67052-8272

Mail: info@fsbondtec.at

Web: www.fsbondtec.at

Hilpert
electronics

Ihr Vertriebspartner/ Votre représentant:

Hilpert electronics AG
Täferstrasse 29
5405 Baden-Dättwil
Schweiz / Suisse

Tel: +41 56 483 25 25
Fax: +41 56 483 25 20
Mail: office@hilpert.ch
Web: www.hilpert.ch

